

## RFスパッタ装置 SP-3400



本装置は小型研究開発用のスパッタリング装置と小型装置でありながら3インチ用カソードを3源搭載しております。電源は500Wの高周波電源を1台搭載しており、金属・酸化物・絶縁物等の成膜が可能となっております。

又、整合器は自動整合器を2台搭載することにより切替にて逆スパッタも可能となっております。

成膜時の膜厚分布を良くする為に基板回転の機構も標準で搭載しております。

オペレートタッチ画面を採用しており、初心者でも簡単に排気系の自動操作を行うことができます。又、誤作動防止のための安全回路を搭載しております。

ターボ分子ポンプによるクリーンな排気により良質な成膜が行えます。冷却水循環装置、小型コンプレッサはオプションで装備可能です。

## RFスパッタ装置 SP-3400 仕様

- 到達圧力 1.0×10<sup>-4</sup>Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 成膜室径 φ400mm×333mmH SUS304 電解研磨
- スパッタ用電源 RF電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台
- 逆スパッタ機構 有り
- 基板形状 □75mm×25mm 4枚取付可能
- 膜厚分布 ±5%以内(基盤ホルダーφ5インチ領域内にて)
- ターゲット寸法 3インチ×5mm(金属・酸化物・絶縁物)
- ターゲット個数 3
- 基板回転 有り(0~19rpm)
- TS間距離 50~100mmの間にて可変可能(手動)
- 基板加熱 常温~350℃迄昇温可能
- 真空排気系 制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計  
油回転ポンプ:167L/min(50Hz)  
ターボ分子ポンプ:280L/sec
- 操作方法 自動/手動選択可能
- ガス系統 微量流量調整メータリングバルブ1系統
- ユーティリティ 動力:三相AC200V 5.0kVA  
冷却水:3.0L/min以上0.03MPa以上0.1MPa以下25℃以下循環  
計装エア:0.5MPa以上  
寸法:1190W×750D×(1815)Hmm

